

# 产品说明书

# NC-809

## 超低残留助焊剂

### 简介

NC-809 助焊剂是一款无卤、免洗、超低残留的倒装焊助焊剂，独特的配方可以在保持适当的润湿和高粘力的同时最大程度地减少残留物。低残留物有助于底部填充胶和塑封料结合，并在固化过程中减少气体的产生从而减少空洞的形成。NC-809 独特的配方和生产工艺使其具备较高的润湿性，既适用于倒装焊浸蘸应用，也适用于特定的晶圆级 BGA 植球应用。NC-809 的高粘力特性可以使芯片保持在原位，避免出现移位或倾斜等相关的缺陷。

### 特点

- 润湿性能极佳
- 超低残留
- 适用于倒装焊及植球应用
- 高粘力
- 兼容多种底部填充胶(CUF)和塑封料(MUF)
- 浸蘸无桥连
- 无卤
- 免洗

### 属性

	数值	测试方法
颜色	淡黄色	目试检测
典型黏度	17kcps	Brookfield DV-I, 51CPE Spindle @ 5rpm 5 分钟后
典型粘力	250gf	IPC-TM-650: 2.4.44
典型酸价值	110mg KOH/g	滴定法
表面绝缘电阻	合格	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
典型回流后残留物比重	~6%	重量分析
保质期	6个月 (0-30°C)	黏度变化/显微镜检查

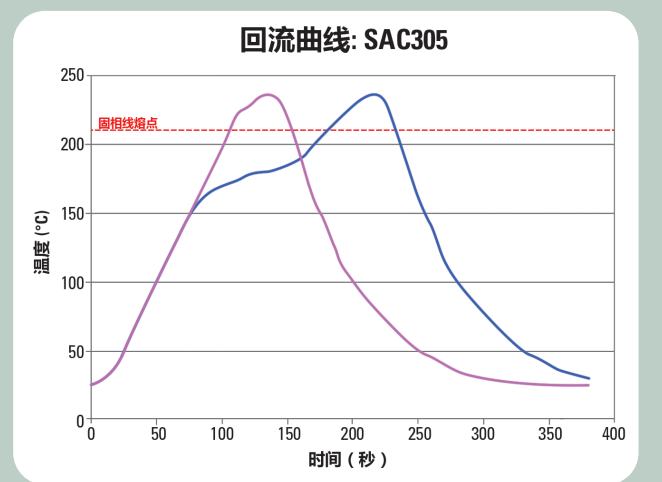
所有信息仅供参考，不作为订购产品的规格说明。

### 应用

NC-809 是一款宽工艺窗口的助焊剂，适用于多种半导体封装应用。黏度适中，适用于倒装焊浸蘸应用；高粘力，可以使芯片保持在原位，从而避免产生移位或倾斜等相关的缺陷。NC-809 极佳的润湿能力使其也适用于特定晶圆级 BGA 植球应用。在上述两种应用中，回流后的残留物都是极少且良性的，可以免去清洗工艺步骤。

### 回流

推荐温度曲线：



NC-809 助焊剂应在氧气含量小于 100ppm 的氮气气氛中进行回流。某些特殊应用也可以尝试在空气中回流。

NC-809 助焊剂适用于多种表面金属处理，包括选择性镀银、裸铜和镍金，并兼容纯锡、锡银、锡银铜等常见无铅合金。

From One Engineer To Another®



表格编号: 99893 (SC A4) R2

## 产品说明书

# NC-809 超低残留助焊剂

### 清洁

NC-809助焊剂专为免洗应用设计。需要时也可用市售清洗剂去除。具体推荐可咨询钢泰公司技术支持工程师。

### 包装

NC-809助焊剂最常用的包装为10克或25克(10毫升或30毫升)注射器包装或100克罐装。其它特殊包装可应要求提供。

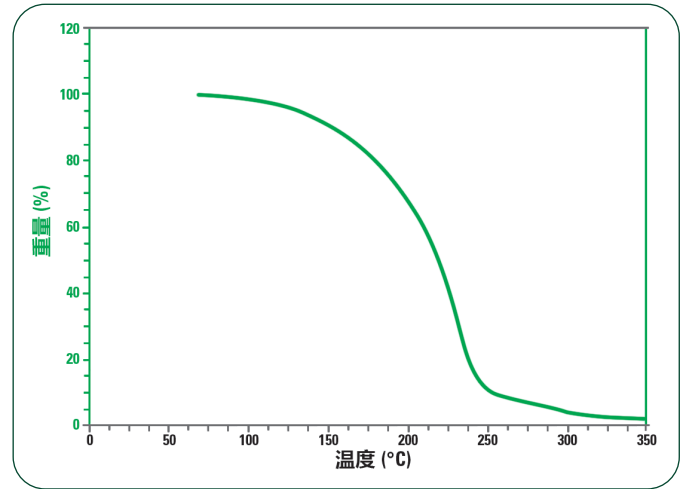
### 储存

NC-809助焊剂注射器和罐筒包装应尖头朝下储存以延长保质期。如果冷藏保存, NC-809助焊剂应在使用前回温至室温。

### 技术支持

钢泰公司快速响应全球客户和坚持提供现场技术支持的高品质服务已成为行业标杆。我们的技术支持工程师为客户提供材料科学和半导体封装工艺应用领域的全方面的专业服务。

### 热重分析 (TGA)



热重分析 (TGA) 采取的升温速度为10°C/分钟。

本产品说明书仅供参考,并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明,钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

钢泰公司的所有焊锡膏和预成型焊片的生产工厂均通过IATF 16949:2016认证。  
钢泰公司是ISO 9001:2015注册公司。

联系我们的工程师: [china@indium.com](mailto:china@indium.com)

有关详情: [www.indiumchina.cn](http://www.indiumchina.cn)

亚洲 +65 6268 8678 • 中国 +86 (0) 512 628 34900 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



©2022钢泰公司